

成都振芯科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币30,000万元，向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币30,000万元，向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币20,000万元，向招商银行股份有限公司武侯支行申请综合授信额度人民币10,000万元。授信有效期均为12个月，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日